证券代码：688432 证券简称：有研硅

有研半导体硅材料股份公司

2026 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

第一节主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

单位：万元币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	39,682.10	25,565.14	28,618.00	38.66	106,162.79	74,656.63	83,468.08	27.19
利润总额	25,023.34	7,008.33	6,465.89	287.01	42,931.35	22,034.87	21,426.72	100.36
归属于上市公司股东的净利润	22,896.40	5,008.33	4,848.35	372.25	36,178.92	15,611.80	15,414.54	134.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,265.26	2,561.85	2,613.73	101.45	14,148.72	9,918.39	9,956.23	42.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	24,798.59	20,104.26	22,160.47	11.90
基本每股收益（元/股）	0.1836	0.0403	0.0390	371.24	0.2902	0.1255	0.1239	134.20
稀释每股收益（元/股）	0.1834	0.0402	0.0390	370.91	0.2899	0.1254	0.1239	134.08
加权平均净资产收益率（%）	4.89	1.15	1.10	增加3.79个百分点	7.80	3.56	3.52	增加4.28个百分点
研发投入合计	1,672.65	2,547.17	2,547.17	-34.33	6,017.45	6,968.70	6,968.70	-13.65
研发投入占营业收入的比例（%）	4.22	9.96	8.90	减少4.68个百分点	5.67	9.33	8.35	减少2.68个百分点
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
			调整前		调整后		调整后	
总资产	656,763.45		549,445.93		565,309.13		16.18	
归属于上市公司股东的所有者权益	479,577.12		452,081.87		451,713.00		6.17	

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2026年1月28日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《有研半导体硅材料股份公司关于收购株式会社DG Technologies股权进展暨收购完成的公告》(公告编号2026-003)。本次收购标的股权转让已完成，公司持有DG Technologies70%的股权，对其财务和生产经营实施控制，本次收购属于同一控制下企业合并，故对上年同期和上年度末比较数据进行重述。

二、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	312,831.05	322,818.71	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,847,144.73	29,658,459.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,116,727.40	39,884,199.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	169,756,242.94	169,756,242.94	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-870,894.86	
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,727.79	708,211.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,486,666.72	13,349,661.54	
少数股东权益影响额（税后）	1,290,564.31	5,807,412.69	
合计	176,311,442.88	220,301,962.41	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

三、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	38.66	本报告期市场需求增加，且随着公司募投项目完成，产能释放，产销量增加，销售收入增加。
利润总额_本报告期	287.01	一方面，本报告期，公司受让安徽晶隆半导体科技有限公司60%股权，收购对价与应享有的被合并方可辨认净资产公允价值份额之间的差额确认为营业外收入计入当期损益；同时，市场需求增加，且随着公司募投项目完成，产能释放，产销量增加，利润增加。
利润总额_年初至报告期末	100.36	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	372.25	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	134.71	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	101.45	市场需求增加，且随着公司募投项目完成，产能释放，产销量增加，利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	42.11	
基本每股收益（元/股）_本报告期	371.24	本期归属于上市公司股东的净利润增长所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	134.20	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	370.91	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	134.08	
研发投入合计_本报告期	-34.33	本报告期研发活动支出减少所致。

第二节股东信息

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,654	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）					
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
北京有研艾斯半导体科技有限公司	境内非国有法人	384,750,000	30.77	0	0	无	0
株式会社RS Technologies	境外法人	314,590,400	25.16	0	0	无	0
中国有研科技集团有限公司	国有法人	230,422,500	18.43	0	0	无	0
长江证券股份有限公司－华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	19,751,227	1.58	0	0	无	0
德州芯利咨询管理中心（有限合伙）	其他	14,319,986	1.15	0	0	无	0
广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,514,103	0.76	0	0	无	0
德州芯睿咨询管理中心（有限合伙）	其他	8,559,953	0.68	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6,143,234	0.49	0	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司－华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,865,264	0.39	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,706,727	0.38	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
北京有研艾斯半导体科技有限公司	384,750,000	人民币普通股	384,750,000				
株式会社RS Technologies	314,590,400	人民币普通股	314,590,400				
中国有研科技集团有限公司	230,422,500	人民币普通股	230,422,500				
长江证券股份有限公司－华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	19,751,227	人民币普通股	19,751,227				
德州芯利咨询管理中心（有限合伙）	14,319,986	人民币普通股	14,319,986				
广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	9,514,103	人民币普通股	9,514,103				
德州芯睿咨询管理中心（有限合伙）	8,559,953	人民币普通股	8,559,953				
香港中央结算有限公司	6,143,234	人民币普通股	6,143,234				
国泰海通证券股份有限公司－华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	4,865,264	人民币普通股	4,865,264				
中国银行股份有限公司－易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	4,706,727	人民币普通股	4,706,727				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社RS Technologies实际控制人为方永义。 2、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

第三节其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司于2026年9月11日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》，拟以发行股份及支付现金的方式向中国有研科技集团有限公司、德州汇达半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）购买山东有研艾斯半导体材料有限公司合计71.89%的股权；同时，公司拟以发行股份的方式向德州经济技术开发区景泰投资有限公司购买山东有研半导体材料有限公司14.98%的股权。收购上述股权将同步募集配套资金。本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。具体内容详见公司于2026年9月12日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

第四节季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：有研半导体硅材料股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,113,546,596.92	680,311,970.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,620,232,239.72	1,910,302,191.79
衍生金融资产	20,403,196.88	
应收票据	64,340,392.70	68,497,962.62
应收账款	334,155,441.46	311,388,568.88
应收款项融资	176,300,447.04	90,341,764.46
预付款项	28,127,123.01	52,173,120.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,684,139.47	5,830,944.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,185,965.36	256,138,779.33
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,647,279.23	11,930,796.18
流动资产合计	3,702,622,821.79	3,386,916,098.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	651,772,951.19	686,711,374.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,363,361,818.75	1,353,740,574.73
在建工程	378,048,608.91	60,959,700.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	175,667,741.75	20,318,215.48
无形资产	110,375,348.99	87,033,194.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,560,226.61	9,474,999.23
递延所得税资产	48,641,790.20	17,166,826.47
其他非流动资产	99,583,151.89	770,281.80
非流动资产合计	2,865,011,638.29	2,266,175,166.67
资产总计	6,567,634,460.08	5,653,091,264.75
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,971,806.48	46,555,914.88
应付账款	245,359,472.29	228,003,740.89
预收款项		
合同负债	391,403.65	2,628,146.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,384,870.64	38,393,967.05
应交税费	24,713,612.82	12,229,580.08
其他应付款	189,050,507.16	148,925,859.36
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,199,068.61	14,148,989.53
其他流动负债		
流动负债合计	561,070,741.65	490,886,197.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,428,678.99	9,529,889.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	173,935,410.38	12,768,274.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	113,485,707.29	136,072,234.60
递延所得税负债	831,009.12	35,829.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,680,805.78	158,406,228.64
负债合计	854,751,547.43	649,292,426.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,250,301,858.00	1,250,301,858.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,295,260,550.20	2,310,702,468.62
减：库存股	35,935,687.59	35,935,687.59
其他综合收益	-3,563,275.28	-3,378,729.54
专项储备	10,983,005.91	9,933,457.07
盈余公积	40,023,401.77	40,023,401.77
一般风险准备		
未分配利润	1,238,701,364.13	945,483,273.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,795,771,217.14	4,517,130,041.68
少数股东权益	917,111,695.51	486,668,796.53
所有者权益（或股东权益）合计	5,712,882,912.65	5,003,798,838.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,567,634,460.08	5,653,091,264.75

公司负责人：张果虎主管会计工作负责人：杨波会计机构负责人：李文彬

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：有研半导体硅材料股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,061,627,873.33	834,680,823.23
其中：营业收入	1,061,627,873.33	834,680,823.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	843,556,915.49	669,945,292.25
其中：营业成本	711,417,693.81	543,008,429.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,265,220.30	11,587,522.92
销售费用	15,751,590.36	13,217,361.56
管理费用	41,772,795.27	38,230,196.96
研发费用	60,174,484.72	69,687,038.63
财务费用	3,175,131.03	-5,785,256.94
其中：利息费用	1,279,026.27	641,985.11
利息收入	7,247,926.25	7,607,022.13
加：其他收益	43,876,292.94	61,577,086.57
投资收益（损失以"-"号填列）	-22,915,123.89	-8,689,501.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,183,722.32	-35,684,510.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	21,615,600.98	1,451,855.39
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-448,573.22	-999,757.77
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-1,672,963.11	-5,191,847.68
资产处置收益（损失以"-"号填列）	341,246.00	77,610.72
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	258,867,437.54	212,960,976.27
加：营业外收入	170,466,919.34	1,525,422.95
减：营业外支出	20,892.27	219,198.89
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	429,313,464.61	214,267,200.33
减：所得税费用	39,067,528.61	32,854,001.74
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	390,245,936.00	181,413,198.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	390,245,936.00	181,413,198.59
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	361,789,178.13	154,145,387.16
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	28,456,757.87	27,267,811.43
六、其他综合收益的税后净额	-263,636.77	268,320.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-184,545.74	187,824.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-184,545.74	187,824.06
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-184,545.74	187,824.06
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-79,091.03	80,496.02
七、综合收益总额	389,982,299.23	181,681,518.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	361,604,632.39	154,333,211.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	28,377,666.84	27,348,307.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.2902	0.1239
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2899	0.1239

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-870,894.86元，上期被合并方实现的净利润为：-2,464,337.43元。

公司负责人：张果虎主管会计工作负责人：杨波会计机构负责人：李文彬

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：有研半导体硅材料股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	854,730,944.10	651,890,161.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,377,271.69	15,173,816.99
收到其他与经营活动有关的现金	30,860,041.54	31,508,414.14
经营活动现金流入小计	898,968,257.33	698,572,392.22
购买商品、接受劳务支付的现金	395,265,309.08	241,461,234.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	165,679,228.78	150,467,106.02
支付的各项税费	50,274,771.10	53,795,332.10
支付其他与经营活动有关的现金	39,763,036.21	31,244,059.41
经营活动现金流出小计	650,982,345.17	476,967,732.26
经营活动产生的现金流量净额	247,985,912.16	221,604,659.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,045,000,000.00	5,845,400,000.00
取得投资收益收到的现金	19,550,954.61	25,104,047.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,276.15	105,000.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	342,868,463.08	14,846,985.52
投资活动现金流入小计	6,407,424,693.84	5,885,456,033.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,016,971.77	93,063,361.30
投资支付的现金	5,761,000,000.00	5,960,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	18,716,895.18	25,802,180.24
投资活动现金流出小计	6,090,733,866.95	6,078,865,541.54
投资活动产生的现金流量净额	316,690,826.89	-193,409,508.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		9,800,000.00
偿还债务支付的现金	7,984,598.35	12,235,759.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,689,067.08	85,871,827.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,980,320.00	11,081,796.00
支付其他与筹资活动有关的现金	45,288,070.15	6,361,808.23
筹资活动现金流出小计	133,961,735.58	104,469,395.21
筹资活动产生的现金流量净额	-133,961,735.58	-94,669,395.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,482,639.35	-366,215.53
五、现金及现金等价物净增加额	421,232,364.12	-66,840,459.25
加：期初现金及现金等价物余额	631,735,417.74	914,906,385.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,052,967,781.86	848,065,926.54

公司负责人：张果虎主管会计工作负责人：杨波会计机构负责人：李文彬

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年10月27日

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-047

有研半导体硅材料股份公司关于注销公司2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）于2026年10月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销公司2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意注销2024年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留部分第一个行权期已授予但未获准行权的股票期权合计198.24万份。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

1、2024年9月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过。

同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年9月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-040），独立董事袁少颖受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-042）。

4、2024年9月27日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

5、2024年9月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-043）。

6、2024年10月10日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年10月10日为授予日，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-047）及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（截止授予日）》。

7、2024年10月24日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（公告编号：2024-048），公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。

8、2025年3月14日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就，同意以2025年3月14日为授予日，以9.11元/份的行权价格向34名激励对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、公司于2025年3月15日至2025年3月24日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2025年3月25日披露的《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

10、2025年4月23日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划预留授予完成登记的公告》（公告编号：2025-020），股票期权预留授予登记完成日为2025年4月22日，股票期权预留授予登记数量为90.00万份，股票期权预留授予登记人数为34人。

11、2025年10月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024年第二次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。同时，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面可行权比例为80%，部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权，公司及个人考核不达标部分的股票期权合计75.42万份，公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权。2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权激励对象为92名，行权数量为268.08万份，行权价格为9.05元/股。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

12、2025年10月28日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：2025-037)及《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》(公告编号：2025-038)。

13、公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期第一次行权新增股份于2025年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的激励对象为92人，行权股票数量为268.08万股，上市流通时间为2025年12月18日。行权后，公司总股本由1,247,621,058股变更为1,250,301,858股。

14、2025年12月13日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股票上市的公告》(公告编号：2025-044)。

15、2026年10月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024年第二次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由9.05元/股调整为8.995元/股。同时，第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2024年股票期权激励计划2025年绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。本激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期，公司层面2025年业绩考核达到触发值但未达到目标值，可行权比例为50%；部分激励对象因个人考核条件未达成A不能完全行权；首次授予激励对象中有1名激励对象因离职不可行权。综上，本次激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就人员合计91人，可行权的股票期权数量合计164.10万份；预留授予部分第一个行权期行权条件成就人员合计34人，可行权的股票期权数量合计12.96万份；上述已获授予但未获准行权的股票期权数量合计198.24万份将予以注销。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

二、本次注销部分股票期权的情况

1、注销原因

根据《激励计划（草案）》的相关规定，2024年股票期权首次授予的激励对象中1人因离职，不再具备激励对象资格，公司将注销其全部已获授但未获准行权的8.40万份股票期权。

鉴于本激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期，公司层面2025年业绩考核达到触发值但未达到目标值，可行权比例为50%；部分激励对象因个人考核条件未达成A不能完全行权。公司将注销该部分已授予但未获准行权的189.84万份股票期权。

2、注销数量

综上，公司拟注销的股票期权合计198.24万份。

三、本次股票期权注销对公司股权结构和上市条件的影响

公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、薪酬和考核委员会意见

薪酬和考核委员会认为：公司本次注销2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《激励计划（草案）》等相关规定，决策程序合法合规。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，薪酬和考核委员会一致同意公司对相关股票期权予以注销处理。

五、法律意见书的结论性意见

北京德恒律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权已取得了现阶段必要的批准与授权；公司本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，并按照有关规定办理本次注销股票期权的相关手续。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年10月29日

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-051

有研半导体硅材料股份公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年11月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年11月16日14点30分

召开地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月16日

至2026年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司部分制度的议案	√
2.01	董事会议事规则	√
2.02	独立董事工作制度	√
2.03	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度	√
2.04	股东会议事规则	√
2.05	募集资金管理制度	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.04

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688432	有研硅	2026/11/9

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东可采用信函或电子邮件的方式进行预约。采用电子邮件预约的请于2026年11月13日17时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱gritekipo@gritek.com进行预约登记；信函预约的以收到邮戳为准，信函上请注明"股东会"字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或护照等其他能够表明身份的有效证件或证明（身份证件）；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1）；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1）。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，现场参会人员建议至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式

地 址：北京市西城区新街口外大街2号D座17层

邮编：100088

联系人：孙媛

电 话：010-82087088

电子邮箱：gritekipo@gritek.com

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年10月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

有研半导体硅材料股份公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订公司部分制度的议案			
2.01	董事会议事规则			
2.02	独立董事工作制度			
2.03	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度			
2.04	股东会议事规则			
2.05	募集资金管理制度			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-046

有研半导体硅材料股份公司关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股票期权拟行权数量：177.06万份。其中，首次授予部分第二个行权期可行权164.10万份，预留授予部分第一个行权期可行权12.96万份。
- 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"、"有研硅"）于2026年10月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确认公司2024年股票期权激励计划2025年绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。根据《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期的行权条件已经成就。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）股票期权激励计划方案及履行程序

1、2024年9月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过。

同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年9月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-040），独立董事袁少颖受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-042）。

4、2024年9月27日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

5、2024年9月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-043）。

6、2024年10月10日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年10月10日为授予日，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《有研半导体硅材料股份公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-047）及《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（截止授予日）》。

7、2024年10月24日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（公告编号：2024-048），公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。

8、2025年3月14日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就，同意以2025年3月14日为授予日，以9.11元/份的行权价格向34名激励对象授予90.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、公司于2025年3月15日至2025年3月24日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2025年3月25日披露的《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

10、2025年4月23日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划预留授予完成登记的公告》（公告编号：2025-020），股票期权预留授予登记完成日为2025年4月22日，股票期权预留授予登记数量为90.00万份，股票期权预留授予登记人数为34人。

11、2025年10月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024年第二次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由9.11元/股调整为9.05元/股。同时，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案》《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面2024年业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面可行权比例为80%，部分激励对象因个人考核条件未达成A导致不能完全行权，公司及个人考核不达标部分的股票期权合计75.42万份，公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权。2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权激励对象为92名，行权数量为268.08万份，行权价格为9.05元/股。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

12、2025年10月28日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：2025-037)及《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》(公告编号：2025-038)。

13、公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期第一次行权新增股份于2025年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的激励对象为92人，行权股票数量为268.08万股，上市流通时间为2025年12月18日。行权后，公司总股本由1,247,621,058股变更为1,250,301,858股。

14、2025年12月13日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股票上市的公告》(公告编号：2025-044)。

15、2026年10月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据2024年第二次临时股东大会的授权，对2024年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由9.05元/股调整为8.995元/股。同时，第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2024年股票期权激励计划2025年绩效考核结果的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司2024年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。本激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期，公司层面2025年业绩考核达到触发值但未达到目标值，可行权比例为50%；部分激励对象因个人考核条件未达成A不能完全行权；首次授予激励对象中有1名激励对象因离职不可行权。综上，本次激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就人员合计91人，可行权的股票期权数量合计164.10万份；预留授予部分第一个行权期行权条件成就人员合计34人，可行权的股票期权数量合计12.96万份；上述已获授予但未获准行权的股票期权数量合计198.24万份将予以注销。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

（二）历次股票期权激励计划授予情况

批次	授予日期	授予价格	授予股票期权数量	授予激励对象人数	授予后权益剩余数量
2024年股票期权激励计划首次授予	2024年10月10日	9.11元/份	1,145.00万份	92人	90.00万份
2024年股票期权激励计划预留授予	2025年3月14日	9.11元/份	90.00万份	34人	0.00万份

（三）历次激励对象人数、期权数量、行权价调整情况

1、2025年10月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司实施2024年年度权益分派，根据2024年第二次临时股

（下转B037版）